|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| とうきょうこうしゃ | | | | | | 取扱注意   |  |  | | --- | --- | | 連携を希望する  テーマ(キーワード) |  | | | | |
| 東京公社株式会社　※例示は削除して入力して下さい | | | | | |
| 所在地 | [本社]〒  [都内所在地] 〒 | | | | | | | | |
| 資本金 | 万円 | | 従業員数 | 名 | | | 設立年（西暦） | | 年 |
| 主要事業 |  | | | | | | | | |
| Webサイト |  | | | | | | | | |
| 連絡先（部署・氏名） |  | | | | | | | | |
| TEL |  | | Eメール |  | | | | | |
| * 得意な技術・製品 | |  | | | | | | | |
| * 得意な顧客・市場分野 | |  | | | | | | | |
| * 生産拠点・研究体制 | |  | | | | | | | |
| * 特記事項（取得資格・認証等） | |  | | | | | | | |
| * 大学・研究機関に求める取組（いずれかにチェック） | | | | | | | | | |
| ☐共同研究 | | ☐委託研究 | | | ☐学術/技術指導 | | | ☐性能評価・試験・解析 | |
| * 取組・相談内容 | | | | | | | | | |
| 【背景・目的】  【これまでの取組・進捗状況】  【解決したい技術課題】 | | | | | | | | | |
| とうきょうこうしゃ  ひらがなで記入。法人格（かぶ）等は不要。  **記入例** | | | | | | 取扱注意   |  |  | | --- | --- | | 連携を希望する  テーマ(キーワード) | ドローン、AI、画像解析  共同研究や評価を希望する  製品や技術等を記入 | | | | |
| 東京公社株式会社　※例示は削除して入力して下さい | | | | | |
| 所在地 | [本社]〒196-0033　東京都昭島市東町3-6-1  上段に本社（都外も可）、下段に都内事業所を記入。  [都内所在地]　同上 | | | | | | | | |
| 資本金 | 1,500万円 | | 従業員数 | 20名 | | | 設立年（西暦） | | 2000年 |
| 主要事業 | ドローン・AIを活用した画像解析 | | | | | | | | |
| Webサイト | http://www.technology-tama.jp/ | | | | | | | | |
| 連絡先（部署・氏名） | 開発グループ　チームリーダー　公社　太郎 | | | | | | | | |
| TEL | 042-500-3901 | | Eメール | ntc-koryukai@tokyo-kosha.or.jp | | | | | |
| * 得意な技術・製品 | | AIの活用によるデータ処理・分析  国内外の生産拠点（工場）、研究所等を記入。 | | | | | | | |
| * 得意な顧客・市場分野 | | \*\*\*業界、\*\*\*業界 | | | | | | | |
| * 生産拠点・研究体制 | | 研究所（\*\*\*県\*\*\*市）、工場（タイ・バンコク）、〇〇大学と共同研究実績あり | | | | | | | |
| * 特記事項（取得資格・認証等） | | ISO\*\*\*\*\*取得（2005年）、\*\*\*\*\*の特許取得、\*\*\*ビジネスプランコンテスト優勝 | | | | | | | |
| * 大学・研究機関に求める取組（いずれかにチェック）   必ずチェック(☒) | | | | | | | | | |
| ☒共同研究 | | ☐委託研究 | | | ☐学術/技術指導 | | | ☐性能評価・試験・解析 | |
| * 取組・相談内容 | | | | | | | | | |
| 【背景・目的】   * 大学や研究機関に対し共同研究や委託研究を依頼する背景、   目的について記載して下さい。  技術領域や市場についてもわかるように記載して下さい。  ＳＡＭＰＬＥ   1. 技術領域：既存技術・製品の改良/新技術・製品の開発 2. 市場領域：既存市場向け/新市場向け　（具体的に）   【これまでの取組・進捗状況】   * 上記の取組・進捗状況について記載して下さい。   【解決したい技術課題】   * ★　大学や研究機関に対し解決してほしい技術課題と要望を可能な限り、具体的に記載して下さい。  1. 解決したい問題点　②解決対象は何か（材料、工法、システム等、）　③具体的な達成目標　等     （例）難加工材●●●の加工において、■■技術を活用し、公差▲▲μｍの加工精度を達成したい。  ■◆データを活用し▲▲IoTデバイスを製品化したい。  AIを活用した■◆について、製品の性能仕様水準達成可否判断に必要なデータを獲得したい。 | | | | | | | | | |

**■秘密保持契約について**

【産学連携希望シート】は大学・研究機関限りで配布します。秘密保持契約は締結しませんので、機密情報の記載はお控え下さい。個別面談開始後の秘密保持については、企業と大学・研究機関間で取り決めを行って下さい。

**■その他**

・専門用語には解説をつけて下さい。

・全体的な体裁を整える為、公社で微修正を入れることがございます。予めご了承下さい。